

第 34 回 マイクロエレクトロニクスシンポジウム

MES2024 論文募集

開催日・講演発表日:2024年9月11日(水)~13日(金)

開催会場:大同大学(名古屋市)&オンライン開催

発表・展示申込期間:2024年4月中旬~6月14日(金)

論文提出期間:2024年6月28日(火)~7月22日(月)

一般社団法人エレクトロニクス実装学会(JIEP)は、第34回マイクロエレクトロニクスシンポジウム(MES2024)を開催します。詳細および最新の情報は随時学会ウェブサイト(<http://jiep.or.jp/>)に掲載します。

【1】一般発表申込

募集論文:エレクトロニクス実装に関する広範な技術・研究論文

- 1) 先端プロセス・実装技術(配線板、インターポーザ、積層技術、チップレット、ハイブリッドボンディングなど)
- 2) パワーエレクトロニクス実装技術(パワーデバイス実装、サーマルマネジメント、高熱伝導材料、耐熱材料など)
- 3) 高速高周波実装・電磁特性技術(電源回路、高速伝送線路、アンテナ、ワイヤレス給電、人体通信、EMC、ミリ波など)
- 4) マイクロメカトロニクス実装技術(MEMS、封止パッケージング、常温接合、センサ・アクチュエータなど)
- 5) 光回路実装技術(光インタコネクション、CPO、光モジュール、シリコンフォトニクスなど)
- 6) プリントابل・ウェアラブル・バイオエレクトロニクス(アディティブマニファクチャリング、バイオセンサ、生体適合性材料など)
- 7) 環境調和型エレクトロニクス(グリーンエネルギー、蓄電池、光電変換、環境調和型実装材料など)
- 8) 信頼性技術(熱応力、機械疲労、マイグレーション、寿命予測など)
- 9) シミュレーション・計算機による評価・設計(AI活用、機械学習、熱応力解析、疲労解析、回路シミュレーションなど)
- 10) めっき技術(配線形成、スルーホールめっき、高密着技術、表面処理など)
- 11) 最先端材料(配線材料、接合材料、基板材料、ナノマテリアル、メタマテリアルなど)
- 12) その他

発表形式:口頭発表 または ポスター発表

- ・ 発表言語は日本語(英語での発表をご希望の方は事前にお知らせ下さい)
- ・ 発表者は現地参加をお願いします

口頭発表:発表時間20分(説明15分、質疑5分)

ポスター発表:ポスター展示(幅90×高さ118cm)、コアタイムにおける説明、ショートプレゼンテーション

申込:学会ウェブサイトからMES論文発表申込ページに入り、発表者情報、要旨(200文字~350文字)などを登録して下さい。

- ・ 要旨受付期間:2024年4月中旬~6月14日(金)
- ・ 申込資格:特になし(非会員の方も発表可能です)
- ・ 登壇者も賛助会員向けクーポンの使用可

審査:提出された要旨に基づき、本シンポジウムにおける採否をMES論文委員会で審査します。

- ・ 審査結果通知:2024年6月下旬(Eメールでお知らせします)

本論文:採択の場合、審査結果通知と同時に論文執筆要領などについてお知らせします。

- ・ 論文提出期間:2024年6月25日(火)~7月22日(月)
- ・ 原稿はA4横書き、1~4ページ
- ・ 本論文は、フォーマットを利用してMS Wordなどのワープロソフトで作成の上、PDFに変換したファイルをウェブサイトから提出して下さい

参加登録：7月31日(水)まで早期優遇価格（消費税込、賛助会員向けクーポンの使用可）
正会員・賛助会員・共催学会員 15,000 円、協賛学会員 20,000 円、非会員 28,000 円
学生会員・共催学生会員 3,500 円、協賛学生会員 4,500 円、非会員学生 5,500 円（学生はいずれも交流会参加費込）

交流会参加費：6,000 円

表彰：優秀な発表に対し、賞を授与します（対象は筆頭著者である会員が行った一般発表）。

論文集：電子版はウェブサイトからダウンロードして下さい（発行予定日：2024年9月10日）。
冊子版は3,000円にて販売しますので、希望者は参加登録の際にオプションよりお申込み下さい。
冊子版の送付は大会終了後2～3週間後になります。
（特別講演者・依頼講演者・企業展示は1冊無料で送付します）

【2】企業展示・プレゼンテーション・広告募集

内容：展示スペース、企業プレゼンテーション、バナー広告、広告掲載、から希望の形式（複数可）を選択
（展示スペース）ポスター、カタログ、技術サンプル等（商用100V電源は利用可能）
1スペース：机（180cm×60cm）、椅子、ボード（幅90cm×高さ118cm）各1個
・追加で説明員を配置する場合は、10,000円/人（交流会費込）にて参加登録をお願いします
・展示品は各社で搬入・設置・撤去願います。学校構内は駐車スペースがありませんので、宅配便等
をご利用下さい。送り先などの詳細は、8月末頃、連絡します。

（企業プレゼンテーション）1社10分の技術説明（製品説明を含むことも可です）

予稿はA4横書き1ページの論文形式、またはポスター内容の縮小版などでも掲載可能

予稿原稿提出期限：2024年7月22日（月）

（バナー広告）大会サイトへのバナー広告掲載（期間は2024年6月末～2024年10月末）

バナーデータ、リンクURLの提出期限：2024年6月14日（金）

（広告掲載）論文集への広告掲載（A4サイズ1ページ）

原稿入稿期限：2024年6月14日（金）

申込：学会ウェブサイトからMES論文発表申込ページに入り、発表者情報、出展形式、出展概要（約300字）などを登録して下さい。

展示費用：会員、賛助会員50,000円、非会員100,000円（消費税込、1名分の参加登録費込）

【お願い】いずれの発表においても、登録後の発表取り下げはご遠慮下さい。

問合・申込：一般社団法人 エレクトロニクス実装学会 MES事務局
TEL 03-5310-2010 E-Mail mes2024@jiep.or.jp

共催/大同大学、(一社)スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会
協賛/予定

IEEE EPS Japan Chapter, 映像情報メディア学会, 応用物理学会, 化学工学会, 関西サイエンス・フォーラム, KEC 関西電子工業振興センター, 高分子学会, 精密工学会, 電気化学会, 電気学会, 電子情報技術産業協会, 電子情報通信学会, 日本機械学会, 日本セラミックス協会, 日本電子回路工業会, 日本電子材料技術協会, 日本ロボット工業会, 光産業技術振興協会, 表面技術協会, 溶接学会, 粉体粉末冶金協会